

## 2017年 関西表面技術シンポジウム

次世代めっき技術の深化と新たな成長が期待できる分野への展開

電気鍍金研究会

表面技術協会関西支部

表面技術協会ウェットプロセス研究部会

電気鍍金研究会の「次世代めっき技術連携開発プロジェクト第3期」の最終報告と表面技術協会関西支部の特別講演会を兼ねて表記のシンポジウムを開催いたします。

多数ご参加くださいますようお願い申し上げます。

日時： 平成29年7月26日(水) 13:30~17:00

会場： 大阪鍍金会館 (〒537-0025 大阪市東成区中道3-1-14)

JR環状線 玉造駅 下車徒歩5分

参加費： 会員 3,000円, 学生 1,000円, 非会員 6,000円 (いずれもテキスト代含む)

申込方法： 参加希望者は、申込み書に必要事項をご記入の上、7月7日(金)までにファックスで

お申し込みください。なお、参加費は当日徴収いたします。

申込先： 電気鍍金研究会事務局 (〒537-0025 大阪市東成区中道3-1-14 大阪鍍金会館内)

TEL/FAX 06-4259-6890

定員： 90名 (先着順)

### プログラム

#### 13:30-14:20 講演：「パルス電解法によるめっき膜への影響」

(名古屋市工業研究所) 三宅 猛司

パルス電解法は電解条件の最適化を図ることで微細な膜組織を得ることが可能な手法の1つであり、これにより膜の各種特性向上が期待できる。本講演では、各種めっき浴からのパルス電解条件が及ぼすめっき膜組織と硬度への影響について紹介する。

14:20-14:30 休憩：

#### 14:30-15:20 講演：「Cu/ガラス構造の常温高密着化」

(日本大学) 渡邊 満洋

微小電気機械システム(MEMS)や電子部品実装において、高信頼性かつ高精度なCu/ガラス構造を作製することは重要課題の一つである。本講演では、ガラス表面への金属ドーブならびに貴金属触媒効果を用いた常温密着性向上プロセスについて紹介する。

15:20-15:40 休憩：

#### 15:40-17:00 ポスタープレゼンテーション(各2分間のショートプレゼンテーションを含む)：

1. 低水素脆性亜鉛系めっきの開発 (広島工業大学) 日野 実
2. 電子デバイス用めっき材料に関する研究 (大阪府立大学) 近藤和夫
3. めっき廃液などからの低コスト高効率な貴金属回収技術の開発 (兵庫県立大学) 八重真治
4. 非晶質Cr-C合金めっきの開発 (大阪技術研・和泉センター) 林 彰平
5. 非懸濁めっき法を用いた固体酸化物型燃料電池アノード材料の作製 (岡山大学) 林 秀考
6. めっき・表面処理技術を用いたリチウム電池用電極の作製 (大阪技術研・森之宮センター) 小林靖之
7. 金属—絶縁物同時無電解析出法による金属—絶縁物コンポジット膜の作製2 (奈良工業高等専門学校) 藤田直幸

※ポスタープレゼンテーションは、発表時間中に発表者と聴講者が自由に質疑応答できます。「次世代めっき技術連携開発プロジェクト」の企業と研究者のマッチングのために活用ください。

FAX 送信票

平成 29 年 月 日

電気鍍金研究会 事務局 御中

FAX : 06-4259-6890

2017 年関西表面技術シンポジウム  
次世代めっき技術の深化と  
新たな成長が期待できる分野への展開  
参加申し込み

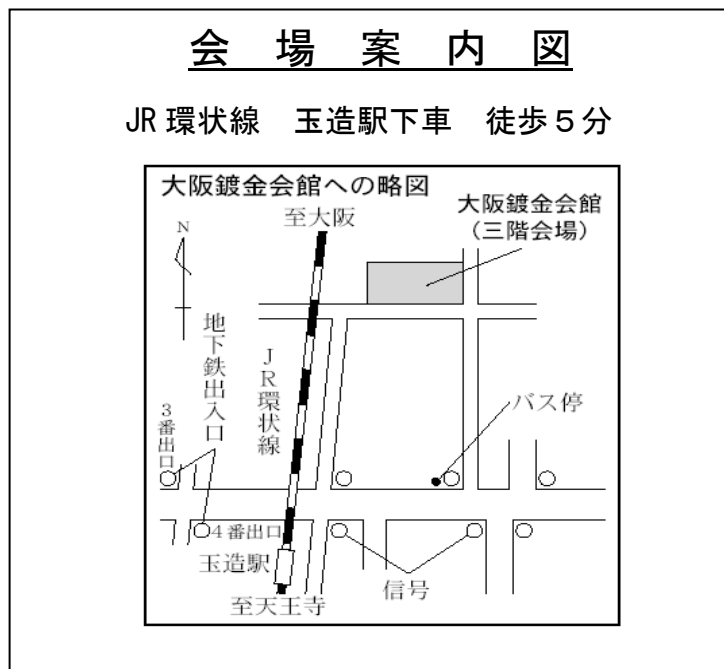
氏名 \_\_\_\_\_

社名/所属 \_\_\_\_\_ 部署 \_\_\_\_\_

TEL \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

会員資格（該当するものを全てチェックして下さい）

- 電気鍍金研究会     表面技術協会     学生     会員外



申込先：電気鍍金研究会事務局 TEL/FAX 06-4259-6890

大阪市東成区中道 3-1-14 大阪鍍金会館内